Платформа системного блока Shuttle «DH670 «1.3L, Alder lake-s Pentium/Celeron/Core 65 Вт LGA1700, 2 x DDR4 3200MHz (max 64Gb), HDMI 2. x 2+ DisplayPort x 2, Quad video outputs,4K playback, M.2 PCIE 2230 E key/2280/2260/2242 M key, USB3.2 gen 2*4/ USB3.2gen1*4/Intel i211 Gigabit Lan*2/RS232

Основные характеристики

Маркетинговый признак производителя (категория)	Intel
Модельный ряд	XPC Slim
Тип	Рабочая станция
Форм-фактор корпуса	SFF
Центральный процессор	Не установлен

Материнская плата

Форм-фактор мат. платы	Проприетарный (собственный)
Разъем для процессора	LGA1700
Разъемов для установки процессора	1
Чипсет	Intel H670
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 4.0	Да
PCI-E M2	1
SATA 6 Gb/s	1
Аудиочипсет	Realtek ALC662

Оперативная память

Тип оперативной памяти	DDR4
Форм-фактор модуля памяти	SODIMM
Максимальная поддерживаемая частота, МГц	3200
Количество слотов памяти	2

Устройства хранения информации

Установка HDD/SSD	Устанавливается пользователем
Описание носителя 1	1x 2.5" SATA3 + 1x M.2 2280

Графический процессор

Чипсет интегрированного видеоадаптера	Зависит от установленного процессора
Тип видеопамяти	Выделяется из оперативной памяти

Устройства считывания информации

Картридер	SD/SDHC/SDXC

Сетевые коммуникации

Сетевой контроллер	Intel i210 + Intel i211
Количество портов Ethernet	2
Скорость сетевого интерфейса	10/100/1000

Разъемы на передней/верхней/боковых панелях

USB 3.2 Gen2/3.1 Gen2 Type-C, передн. панель	1
USB 3.2 Gen2/3.1 Gen2, передн. панель	1
USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, передн. панель	2
Аудио разъемы, передн. панель	2

Разъемы на задней/нижней панелях

USB 3.2 Gen2/3.1 Gen2, задн. панель	2
USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0, задн. панель	2
Com (Serial, DB9, RS232), задн. панель	2
LAN (RJ-45), задн. панель	2
HDMI-Out, задн. панель	2
Display Port-Out, задн. панель	2
Power Input, задн. панель	1

Конструктивные особенности корпуса

Внутренние отсеки 2,5"	1
Материал	Пластик, сталь
Цвет	Черный
Индикация	Включение, LAN, HDD
Мощность блока питания	120
Стандарт блока питания	Внешний

Прочие характеристики

Крепление VESA	Кронштейн в комплекте
Ширина, мм	165
Высота, мм	43
Глубина, мм	190
Особенности	Поддержка CPU Intel Core i3/i5/i7 Gen.12, Pentium, Celeron с TDP до 65W. Слот M.2 2230 E-key для опционального модуля WiFi/BT. Поддержка Windows 10/11 64bit, Linux
Ссылка на описание	https://global.shuttle.com/news/productsSpec?productId=2639
Комплект поставки	Инструкция, комплект кабелей, крепежный комплект, внешний адаптер питания с кабелем, кронштейн VESA, диски с ПО (опция), термопаста (опция)